

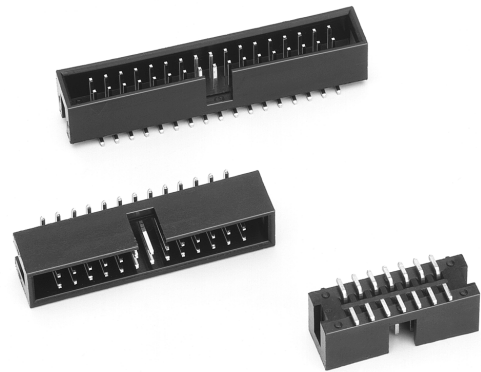
# 9510

## SMT-Wannenstecker - RM 2,00 mm

### SMT-Box Header - Pitch 2,00 mm

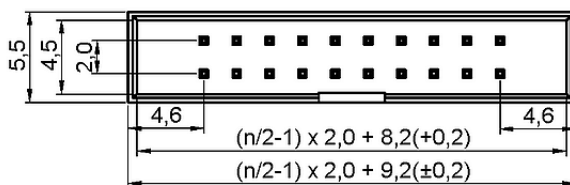
#### Technische Daten / Technical Data:

Isolierkörper <i>Insulator</i>	Thermoplastischer Kunststoff, nach UL94V0 <i>Thermoplastic, rated UL94V0</i>
Kontaktmaterial <i>Contact Material</i>	Vierkantstift □ 0,50 mm, CuZn 30 <i>Square Pin □ 0,50 mm, CuZn 30</i>
Kontaktoberfläche <i>Contact Surface</i>	lt. Oberflächenoptionen, über Ni (1,3-2,5 µm) <i>acc. to options (see below), over Ni (1,3-2,5 µm)</i>
Lötbarkeit <i>Solderability</i>	IEC512-12A
Durchgangswiderstand <i>Contact Resistance</i>	≤ 30 mOhm
Isolationswiderstand <i>Insulation Resistance</i>	> 5x10 <sup>8</sup> Ohm
Spannungsfestigkeit <i>Test Voltage</i>	1000 V <sub>DC</sub>
Nennspannung <i>Current Voltage</i>	250 V <sub>AC</sub>
Nennstrom <i>Current Rating</i>	1 A
Temperaturbereich <i>Temperature Range</i>	-40°C...+105°C
Verarbeitung <i>Processing</i>	Reflow-Lötverfahren; weitere Informationen in Kapitel T <i>Reflow-Soldering, further informations in chapter T</i>

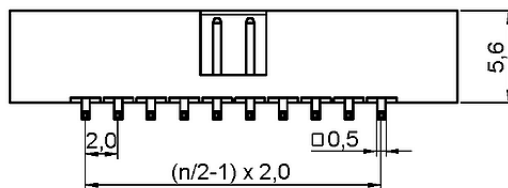
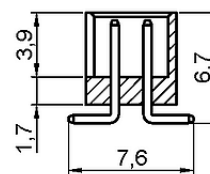


© W+P PRODUCTS

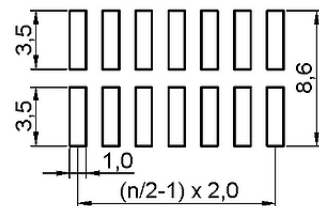
Passender Gegenstecker Serie:  
*Mates with Connector Series:*  
343



n = Anzahl der Kontakte  
n = No. of Contacts



#### PCB-Layout



Series	Contacts*	Plating	Insulator	Packing*
9510	14 06/08/10/12/14/16/20/ 22/24/26/30/32/34/36/ 40/44/50/60/64/68-pol.	00 00 = vergoldet gold plated	HT HT = High-Temp-Isolierkörper Nylon 6T high temp. insulator Nylon 6T	00 PPTR PPST

#### Lieferformen / Packing Options:

00 = Schüttgut ohne PP-Pad / *bulk goods w/o PP-Pad*  
PPTR = mit PP-Pad, Tape & Reel Verpackung / *Tape & Reel Packing w/ PP-Pad*  
PPST = in Stangen mit PP-Pad / *in tubes w/ PP-Pad*

(\* Bestellbeispiel - Bitte durch Ihre Spezifikationen ersetzen.  
\* Order example - To be replaced by your specifications.)

TEL.: +49 5223 98507-0  
FAX : +49 5223 98507-50

**W+P PRODUCTS**

E-MAIL: sales@wppro.com  
INTERNET: www.wppro.com

# Informationen zum Reflow-Lötverfahren

## Reflow-Soldering Informations

### Reflow-Lötverfahren Reflow-Soldering

Bauteile sollten gemäß folgendem Temperatur-Profil in Anlehnung an die IPC/JEDEC J-STD-020C für bleifreies Lötten im Reflowverfahren verarbeitet werden (Maximalwerte):

Profil Eigenschaft	Bleifreies Lötten
Durchschnitts-Ramp-Up Rate ( $T_{s_{max}}$ to $T_p$ )	3 °C / Sek. Max.
Vorheizen - Temperatur Min ( $T_{s_{min}}$ ) - Temperatur Max ( $T_{s_{max}}$ ) - Zeit ( $t_{s_{min}}$ auf $t_{s_{max}}$ )	150°C 200°C 60-180 Sekunden
Verbleiben oberhalb: - Temperatur ( $T_L$ ) - Zeit ( $t_L$ )	217°C 60-150 Sekunden
Peak/Klassifizierung Temperatur ( $T_p$ )	260°C +/- 5°C
Zeit innerhalb von 5°C um die Peak-Temperatur ( $t_p$ )	20-40 Sekunden
Ramp-Down Rate	6°C / Sekunde max.
Zeit von 25°C bis zur Peak-Temperatur	8 Minuten max.

© W+P PRODUCTS

*Items should be soldered according to IPC/JEDEC J-STD-020C temperature-profile for leadfree reflow-soldering (maximum values):*

Profile Feature	PB-Free assembly
Average Ramp-Up Rate ( $T_{s_{max}}$ to $T_p$ )	3 °C / second max.
Preheat - Temperature Min ( $T_{s_{min}}$ ) - Temperature Max ( $T_{s_{max}}$ ) - Time ( $t_{s_{min}}$ to $t_{s_{max}}$ )	150°C 200°C 60-180 seconds
Time maintained above: - Temperature ( $T_L$ ) - Time ( $t_L$ )	217°C 60-150 seconds
Peak/Classification Temperature ( $T_p$ )	260°C +/- 5°C
Time within 5°C of actual Peak Temperature ( $t_p$ )	20-40 seconds
Ramp-Down Rate	6°C / second max.
Time 25°C to Peak Temperature	8 minutes max.

Empfohlenes Reflow-Lötprofil:

*Recommended Reflow-Soldering profile:*



T